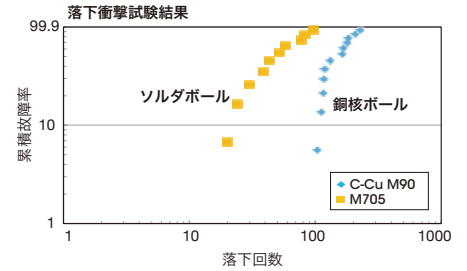


3次元実装の銅核ボールとソフトエラーを防止するLASボール

Cu-core Ball for 3D Packaging & LAS Ball for Soft Errors Prevention

特長

- 優れたはんだメッキ技術が、高品質な三次元実装を容易に
- Ni層を介する銅核ボールは、耐落下衝撃性を向上
- $\phi 20\mu\text{m}$ の狭公差真球ボールで、狭ピッチ実装を実現
- 製品をソフトエラーから守る、低 α 線ソルダボール



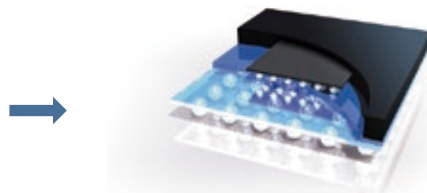
Revolutionary Products

多様化する半導体パッケージに適合するソルダボールを提供



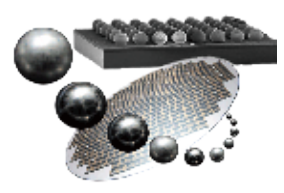
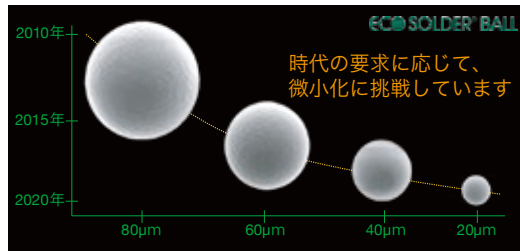
$\phi 240\mu\text{m}$ BGA・CSP

3次元実装を容易にする
銅核ソルダボール



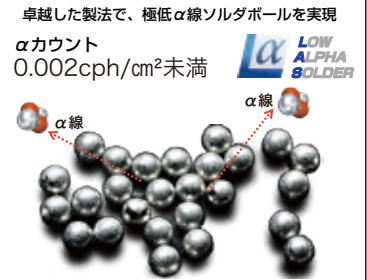
$\phi 180\mu\text{m}$ WLP

狭ピッチ化に対応する
極微小ソルダボール



$\phi 70\mu\text{m}$ μBALL

半導体を誤動作から守る
低 α 線ソルダボール

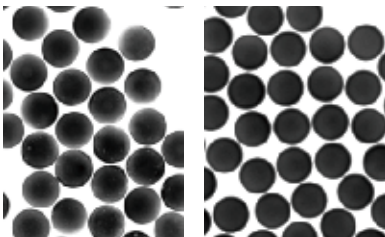


● 接合信頼性の高い銅核ボールで空間確保

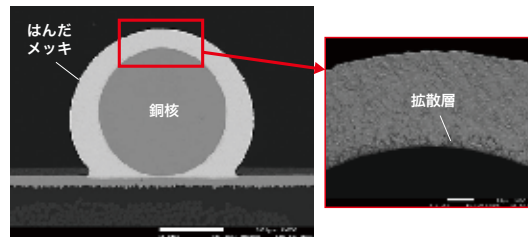
独自のはんだメッキ技術がポイドを抑制

他社製品

SMIC製品



制御されたメッキ被膜は1次リフローで銅を覆い、耐落下衝撃向上の拡散層を形成



左写真の銅核ボールは、2次リフローで良好な接合を得る

